

Pressemitteilung

16.05.2017

Weltneuheit von Heraeus Electronics: Vorgelötete DCB+ Substrate vereinfachen den Produktionsprozess in der Leistungselektronik

- Vorgelötete DCB+ Substrate sparen 50 Prozent der Prozessschritte bei der Chip-Montage ein.
- Das neue Leistungsportfolio von DCB+ bietet zahlreiche Zusatzfeatures und Dienstleistungen, um individuelle DCB-Substrate herzustellen.

Heraeus Electronics führt als wichtigen Bestandteil des neuen Leistungsportfolios für Direct Copper Bonding Substrate vorgelötete Substrate ein, die 50 Prozent der Prozesse bei der Chip-Montage einsparen. Das DCB+ Substrat mit vorappliziertem und aufgeschmolzenem Lot macht den Lotauftrag und insbesondere die aufwendige und kritische Reinigung von Rückständen nach dem Lötprozess überflüssig. Bislang war der Reinigungsschritt einer der größten Kostentreiber. Durch das vorgelötete DCB+ Substrat wird die Lotspritzerrate deutlich reduziert und die Ausbeute dadurch erhöht. Ein weiterer Vorteil sind Einsparungen bei Anlageninvestitionen und Verbrauchsmaterialien.

Mehrwert durch Zusatzfeatures von DCB+

Vorgelötete Aluminiumoxid-Metall-Substrate sind Bestandteil des neuen Leistungsportfolios DCB+. Kunden können aus mehreren Leistungskategorien wählen und profitieren im Vergleich zu gewöhnlichen DCBs von mehr Flexibilität, maßgeschneiderten Lösungen und vereinfachten Produktionsprozessen. Die Features umfassen sowohl zusätzliche Dienstleistungen wie auch spezielle Materialeigenschaften und ermöglichen den Kunden die Wahl besonderer Zusatzleistungen in den folgenden vier Kategorien: Eigenschaften („Properties“), Zusätze („Options“), Dienstleistungen („Services“) und Verarbeitung („Processing“).

Mit DCB+ erweitert Heraeus Electronics den Leistungsumfang von DCB-Substraten erheblich und bietet Kunden einen Mehrwert durch individuell gefertigte Substrate mit besonderen Eigenschaften. In allen Leistungsangeboten fließen die Kernkompetenzen von Heraeus Electronics ein, die sowohl die Prozesstechnik als auch unterstützende Services wie Design, Tests und Analysen umfassen.

Für die Zukunft gerüstet

„Mit DCB+ bündeln wir all unsere Kompetenzen und bieten unseren Kunden individuelle Direct Copper Bonding Substrate für höchst anspruchsvolle Anwendungen“, sagt Martin Sattler, Leiter Customer Solutions bei Heraeus Electronics. „Die Erweiterung unseres Produktportfolios um abgestimmte Materialsysteme sichert unsere führende Position auf dem Elektronikmarkt auch in Zukunft.“

Weitere Informationen finden Sie unter: www.herae.us/pre-soldered_dcb

Die Leistungsangebote im Detail:

- **Properties plus**
 - Customized warpage
 - Laser scribing
 - Surface finishing
 - Zirconia toughened
- **Options plus**
 - Burr-free holes
 - Data matrix code
 - AOI
- **Service plus**
 - Matching materials
 - Design
 - Thermal simulation
 - Prototyping
 - Testing
 - Analytics
- **Processing plus**
 - Preapplied solder
 - Preapplied sinter paste

Der Technologiekonzern **Heraeus** mit Sitz in Hanau ist ein 1851 gegründetes und heute weltweit führendes Familienunternehmen. Mit fachlicher Kompetenz, Innovationsorientierung, operativer Exzellenz und unternehmerischer Führung streben wir danach, unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit kontinuierlich zu verbessern. Wir schaffen hochwertige Lösungen für unsere Kunden und stärken nachhaltig ihre Wettbewerbsfähigkeit, indem wir Material-Kompetenz mit Technologie-Know-how verbinden. Unsere Ideen richten sich auf Themen wie Umwelt, Energie, Gesundheit, Mobilität und Industrielle Anwendungen. Unser Portfolio reicht von Komponenten bis zu abgestimmten Materialsystemen. Sie finden Verwendung in vielfältigen Industrien, darunter Stahl, Elektronik, Chemie, Automotive und Telekommunikation. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Heraeus einen Umsatz ohne Edelmetalle von 2,0 Mrd. € und einen Gesamtumsatz von 21,6 Mrd. €. Mit weltweit rund 12.400 Mitarbeitern in mehr als 100 Standorten in 38 Ländern hat Heraeus eine führende Position auf seinen globalen Absatzmärkten. Heraeus ist 2016 von der Stiftung Familienunternehmen als eines der „Top 10 Familienunternehmen“ in Deutschland ausgezeichnet worden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Morvyn Lipinski
Manager Media Relations
Communications & Marketing
Heraeus Holding GmbH
Telefon +49 61 81 35-97 93
E-Mail morvyn.lipinski@heraeus.com